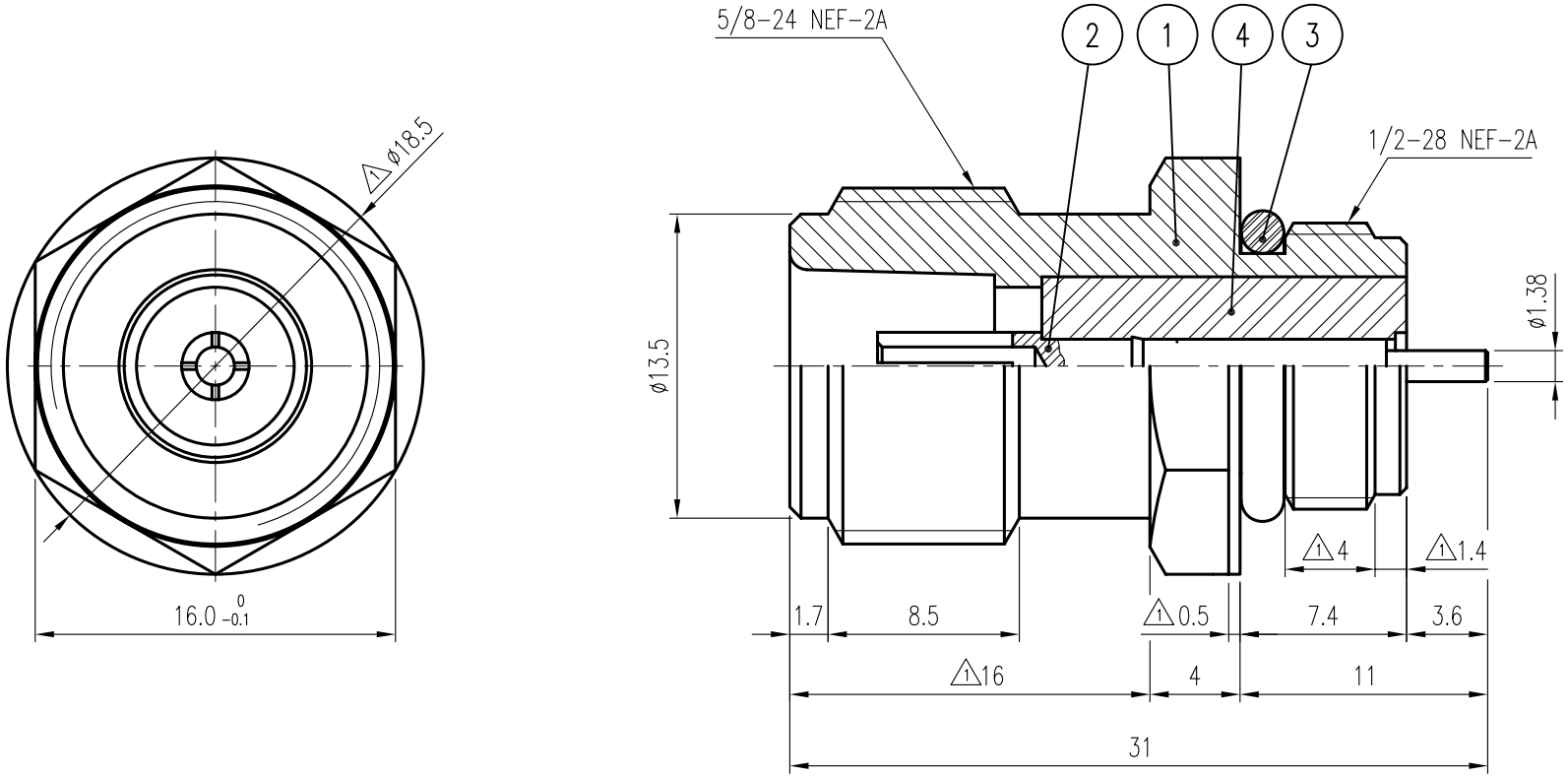
가공 / ST									
ST(기존)									
ST(개선)									

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	소립성 향상 (BODY에 원형판넬 부착, 나사 길이 줄임)	김은희	길준범	2005. 2. 1.
2	신뢰성 향상(설변No.2005-140) (PIN값이 변경 $4^{\pm0.1}$ -> $3.9^{\pm0.02}$)	김은희	유일환	2005. 5. 17.



	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
	4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00671-N/1 (H8216)
	3	GASKET	1	SILICONE RUB	P-10(9.8*1.9)	DGK00033-N/1 (G8037)
△2	2	CONTACT	1	BeCu	Silver Plate(7μm)	DCT00717-5/1 (E8294)
	1	BODY	1	MBsBD	SUCO Plate(3μm)	DBD00952-5/1 (D8305)

대체가능재질

공통공차 소수 각도 분수

재질

열처리

보호피막처리

년월일 2004. 11. 18.

승인

검도

제도

검도

작성부서 연 구 소

척도 3/1 단위 mm 중량

KJ COMTECH

KJ COMTECH CO.,LTD.

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 N-J-BR

A4

도번 CN00802-7/1

K345-541-000